

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/05/2025 | Edição: 91 | Seção: 1 | Página: 28

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Gabinete do Ministro

## PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI Nº 109, DE 5 DE MAIO DE 2025

Altera o Processo Produtivo Básico - PPB para UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, industrializado no País.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º e nos arts. 16 a 19 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo nº 19687.003010/2024-39, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, industrializado no País, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas nas tabelas constantes dos Anexos desta Portaria Interministerial.

§ 1º Para as UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO MONTADAS EM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, de pequena, média ou grande capacidade (NCMs 8471.50.10, 8471.50.20 e 8471.50.30), os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto na tabela constante do Anexo I desta Portaria Interministerial, sendo que a empresa deverá acumular, por ano-calendário, pontuação mínima, conforme o tipo de placa de processamento central (placa-mãe) utilizada pelo SERVIDOR:

- I - placa-mãe do tipo monoprocessada: 432 (quatrocentos e trinta e dois) pontos; e
- II - placa-mãe do tipo multiprocessada: 328 (trezentos e vinte e oito) pontos.



§ 2º Para as UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO MONTADAS EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, de muito grande capacidade (NCM 8471.50.40), os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto na tabela constante do Anexo II desta Portaria, sendo que a empresa deverá acumular a pontuação mínima de pontos por ano-calendário, conforme cronograma:

- I - 2025 a 2026: 240 (duzentos e quarenta) pontos;
- II - 2027: 344 (trezentos e quarenta e quatro) pontos; e
- III - a partir de 2028 em diante: 495 (quatrocentos e noventa e cinco) pontos.

§ 3º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I dos Anexos I e II só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 4º Exclusivamente para os servidores multiprocessados de pequena, média ou grande capacidade (NCMs 8471.50.10, 8471.50.20 e 8471.50.30) que utilizem placas processadoras do tipo lâmina ou modular "blade", a etapa de integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final prevista na etapa XVII dos Anexo I poderá ser considerada atendida, desde que sejam realizadas, no mínimo, a integração dos subconjuntos descritos nos incisos I e II deste parágrafo na formação do produto final:

I - placa e/ou módulo de circuito impresso com função de processamento central, podendo conter partes elétricas e mecânicas previamente agregadas (base inferior e/ou superior metálica, "faceplate" ou "bezel", placas auxiliares sem função de processamento específicas, não especificadas nas etapas IX, X, XI, XII, XIV e XVI do Anexo I, integradas ao "faceplate" ou "bezel" e "backplane"); e

II - processador, módulos de memórias, unidades de armazenamento (HD ou SSD), instalação dos cabos, placas auxiliares com função de processamento e outros componentes que façam parte do produto.

§ 5º Na hipótese de a empresa optar pela utilização da regra estabelecida no § 4º, deste artigo, a pontuação mínima de 328 (trezentos e vinte e oito) pontos para placa multiprocessada estabelecida no §1º deste artigo passará a ser de 342 (trezentos e quarenta e dois) pontos, mantendo-se a proporcionalidade em relação à utilização da regra.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se como UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, as unidades digitais montadas em um mesmo corpo ou gabinete dotadas de placa mono ou multiprocessada (placa-mãe) montada com componentes, sendo a multiprocessada dotada de pelo menos 2 (dois) soquetes individuais para processadores independentes, ou microprocessadores independentes montados em placas com barramento de conexão à placa-mãe.

§ 1º Adicionalmente ao estabelecido no caput o servidor deve apresentar características da seguinte configuração mínima:

I - capacidade de gerenciar no mínimo 8 Gbytes de memória - ECC ("Error Correction Code") e utilizar memória com tecnologia ECC na sua configuração;

II - interface de comunicação para unidades de discos rígidos ou "Solid State Drive" (SSD) com taxa de transferência mínima de 6 Gbits/s;

III - possibilidade de configuração mínima de armazenamento de memória em unidades de disco rígido ou "Solid State Drive" (SSD) de 300 GBytes do tipo hot swap; e

IV - possibilidade de estabelecer espelhamento ("mirroring") ou outras tecnologias de recuperação automática de dados armazenados em unidades de disco rígido ou "Solid State Drive" (SSD).

§ 2º Ficam dispensados de atender o inciso III do § 1º deste artigo os servidores que, por configuração para aplicações específicas, não disponham do recurso "hot-swap" como servidores do tipo "Diskless"; "Clusters" de "Load Balancing" para servidores "Web"; "Clusters" para computação de alto desempenho; servidores de pequeno e médio porte para aplicações de baixa criticidade em geral que contenham apenas um disco interno; servidores tipo "blades" entre outras configurações para aplicações específicas.

Art. 3º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II dos Anexos I e II desta Portaria deverá ser aplicado em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI, observado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos a que se refere esta Portaria, nos termos dos §§1º e 2º do art. 9º do Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 2020.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

§ 4º Alternativamente ao estabelecido no caput deste artigo, o investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) deverá ser aplicado nos Programas e Projetos Prioritários (PPIs), que amparam, respectivamente: o desenvolvimento de programas de computador; projetos de



circuitos integrados; equipamentos e tecnologias para conectividade; ou subsistemas, subconjuntos ou tecnologias de hardware, inclusive afetos ao desenvolvimento de sistemas de energia com melhor desempenho em eficiência energética ou baseados em componentes a base de carbeto de silício (SiC), destinados a servidores de média capacidade (NCM 8471.50.20), de grande capacidade (NCM 8471.50.30) e de muito grande capacidade (NCM 8471.50.40).

§ 5º A alternativa estabelecida no § 4º deste artigo é limitada a 100 (cem) unidades anuais por NCM, por marca proprietária.

Art. 4º Até 31 de dezembro de 2026, para os servidores de média capacidade, de grande capacidade e de muito grande capacidade, os fabricantes poderão optar por seguir as regras estabelecidas nas seguintes Portarias:

I - MCT/MICT nº 03, de 06 de março de 1998, para unidades digitais de processamento de grande capacidade e de muito grande capacidade; e

II - MDIC/MCT nº 19, de 12 de abril de 2000, para unidades digitais de processamento de média capacidade.

Art. 5º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEEXEC/MCTI nº 15.149, de 28 de dezembro de 2021.

Art. 7º A partir de 1º de janeiro de 2027, ficam revogadas as seguintes Portarias Interministeriais:

I - MCT/MICT nº 46, de 08 de abril de 1994;

II - MCT/MICT nº 47, de 08 de abril de 1994;

III - MCT/MICT nº 03, de 06 de março de 1998; e

IV - MDIC/MCT nº 19, de 12 de abril de 2000.



Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO**

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

**LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

#### ANEXO I

Unidade Digital Montada em um mesmo Corpo ou Gabinete, do tipo Servidor, de pequena capacidade (NCM 8471.50.10), de média capacidade (NCM 8471.50.20) e de grande capacidade (NCM 8471.50.30)

| Etapa | Descrição da etapa produtiva  | Pontos Totais |
|-------|---|---------------|
| I     | Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021. | 80            |
| II    | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido, limitado a 60 pontos.   | 60            |
| III   | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central.   | 20            |
| IV    | Corte dos wafers, encapsulamento e teste dos Processadores Principais (CPU).  | 143           |
| V     | Etching ou jet printing do circuito condutivo (antena), encapsulamento da pastilha e soldagem do circuito integrado na antena dos dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID).   | 23            |
| VI    | Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) ou estampagem da carcaça dos gabinetes.   | 49            |
| VII   | Laminação, furação e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central.  | 50            |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| VIII  | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central.  | 90    |
| IX    | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de interface de comunicação, quando não integradas à placa principal.  | 50    |
| X     | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação.   | 65    |
| XI    | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento gráfico dedicado e controle de vídeo, denominadas de unidades de processamento gráfico (GPU). | 60    |
| XII   | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas lógicas da unidade de disco rígido e integração com o HDA.  | 60    |
| XIII  | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.   | 322   |
| XIV   | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM, quando não integrada à placa-mãe.  | 42    |
| XV    | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive e on Board (SSD).   | 129   |
| XVI   | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória não-volátil do tipo Solid State Drive (SSD).  | 18    |
| XVII  | Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.  | 50    |
| XVIII | Testes.  | 10    |
|       | Total  | 1.321 |
|       | Meta para SERVIDORES com placa-mãe do tipo monoprocessada  | 432   |
|       | Meta para SERVIDORES com placa-mãe do tipo multiprocessada   | 328   |

## ANEXO II

Unidade Digital de Processamento Montada em um mesmo Corpo ou Gabinete, do tipo Servidor, de muito grande capacidade (NCM 8471.50.40)

| Etapa | Descrição da etapa produtiva  | Pontos Totais |
|-------|---|---------------|
| I     | Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021. | 80            |
| II    | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido, limitado a 80 pontos.   | 80            |
| III   | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central.   | 20            |
| IV    | Corte dos wafers, encapsulamento e teste dos Processadores Principais (CPU).  | 165           |
| V     | Etching ou jet printing do circuito condutivo (antena), encapsulamento da pastilha e soldagem do circuito integrado na antena dos dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID).   | 22            |
| VI    | Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) ou estampagem da carcaça dos gabinetes.   | 65            |
| VII   | Laminação, furação e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central.  | 60            |
| VIII  | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central.   | 84            |
| IX    | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de interface de comunicação, quando não integradas à placa principal.   | 52            |
| X     | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação.  | 61            |
| XI    | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento gráfico dedicado e controle de vídeo, denominadas de unidades de processamento gráfico (GPU).  | 56            |
| XII   | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas lógicas da unidade de disco rígido e integração com o HDA.   | 58            |
| XIII  | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.  | 262           |
| XIV   | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM, quando não integrada à placa-mãe.   | 33            |



|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| XV                              | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive (SSD) e on Board.  | 176   |
| XVI                             | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória não-volátil do tipo Solid State Drive (SSD).   | 14    |
| XVII                            | Integração dos processadores na placa de processamento central da unidade de processamento.   | 20    |
| XVIII                           | Integração da(s) placas de memória(s) do tipo RAM na placa de processamento central da Unidade de Processamento.  | 20    |
| XIX                             | Integração da(s) unidade(s) de armazenamento de dados (HD e/ou SSD) na placa de processamento central da unidade de processamento ou nos gabinetes de expansão.   | 20    |
| XX                              | Integração da(s) fonte(s) de alimentação no gabinete (ou rack) da unidade de processamento.   | 20    |
| XXI                             | Integração da placa de processamento central (podendo conter estrutura mecânica) no gabinete (ou rack) da unidade de processamento.   | 20    |
| XXII                            | Integração das placas de Interface de dados e/ou comunicação (podendo conter estrutura mecânica), na unidade de processamento de dados ou nos gabinetes de expansão.  | 20    |
| XXIII                           | Teste de segurança (hi-pot) na(s) fonte(s) de alimentação da unidade de processamento.  | 20    |
| XXIV                            | Instalação e roteamento dos cabos de sinal e alimentação de energia elétrica nas gavetas, gabinetes (ou rack).  | 20    |
| XXV                             | Integração dos demais componentes para formação das unidades de processamento de dados, como unidade de distribuição de energia, sistema de comutação de dados, gavetas, trilhos, ventiladores, e outras partes elétricas e mecânicas na formação do produto final. | 50    |
| XXVI                            | Teste funcional de longa duração, certificando configuração, capacidade, desempenho, funcionalidade, integridade lógica e física da informação das unidades de processamento de dados.  | 50    |
| Total                           |   | 1.548 |
| Meta a partir de 2025 até 2026  |   | 240   |
| Meta em 2027                    |   | 344   |
| Meta a partir de 2028 em diante |   | 495   |

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

